

プリントドエレクトロニクス向け材料
光焼結用 亜酸化銅ペースト
「キュアライト®」

低耐熱性基材 (PETフィルム、紙など) への配線形成が可能

特徴

- ✓ 大気下、短時間で焼成可能
- ✓ 低体積抵抗率
- ✓ 細線印刷可能
- ✓ 各種基材との密着性良好
- ✓ 保存安定性良好

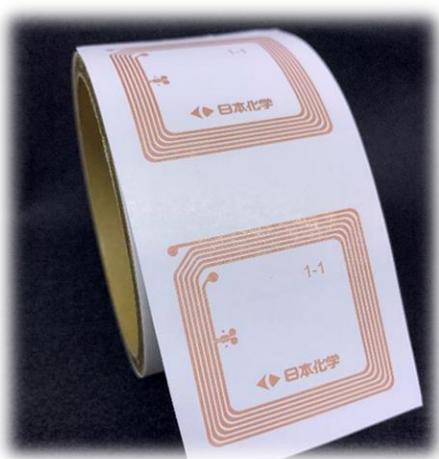


キュアライト®の特性

導電フィラーの種類	亜酸化銅 (Cu ₂ O)
導電フィラー含有量	40 - 80 wt.%
溶媒	有機溶媒
平均粒子径	100 - 200 nm

光焼結膜特性 (プレス後)

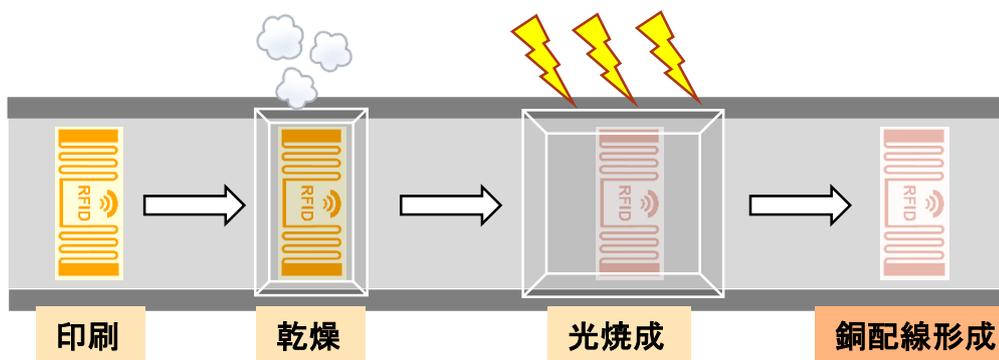
体積抵抗率	< 20 μΩ · cm
膜厚	10 μm
基材	PET, Paper, PI 等
テープ剥離試験	合格



光焼成により形成したRFIDタグ

光焼成プロセス

- ✓ 高い生産効率
- ✓ 低耐熱性基材に対応
- ✓ 省スペース化



用途

RFIDタグ、電磁波シールド、タッチパネル、各種センサー、フレキシブル基板 等

 **日本化学工業株式会社**

研究開発本部 回路材料研究部 回路材料グループ

Tel. 03-3636-8109 / Fax 03-3636-8193

URL <https://www.nippon-chem.co.jp/>